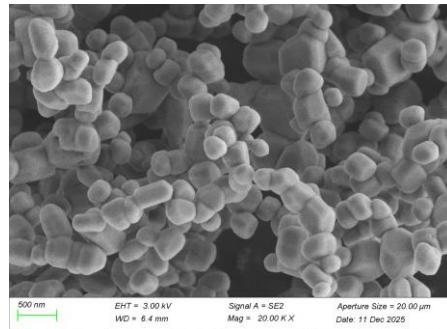


## ★特徴

- ・**0.3μm**の粒径を実現
- ・酸素含有量を**0.5wt%**まで落とすことで、基板、構造部品、TIM材の性能を極限まで引き出します。



AlNフィラーは、優れた熱伝導性と絶縁性を兼ね備えた無機材料であり、電子材料や高性能樹脂複合材に広く使用されています。主成分である窒化アルミニウムは、熱伝導率が高く（理論値：約320 W/m · K）、熱膨張係数がシリコンに近いため、電子デバイスの放熱材料として理想的です。

## ★主な用途

- ・パワー半導体用封止材・モールド材
- ・熱伝導性シリコーンゴム、エポキシ樹脂、ポリイミドなどの充填材
- ・放熱シート、TIM（熱界面材料）、接着剤
- ・高周波基板・LED基板用放熱フィラー

## ★効果・利点

AlNフィラーを使用することで、樹脂複合材料の熱伝導率向上、電気的安定性、および寸法安定性が大幅に改善されます。さらに、微粒径制御や球状化技術により、成形性や表面平滑性にも優れています。